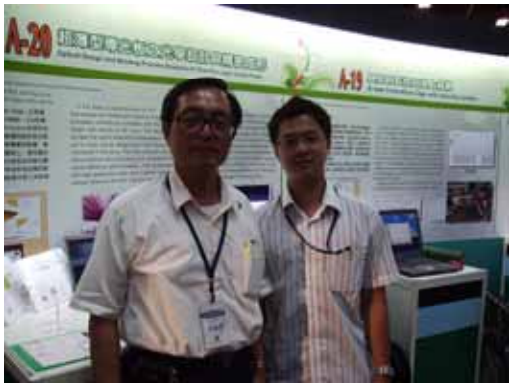
2007 台北國計發明暨技術交易展

研發處提供

2007 台北國計發明暨技術交易展暨研發服務合作聯盟簽約儀式

本校模具系黃俊欽教授率研發團隊以「超薄型導光板光學設計及精密成形」獲選參加『2007 台北國計發明暨技術交易展』。導光板(LGP)是背光模組(backlight)中引導 LED 的點光源成為平面光源的重要零組件。本研究採雙面微 v-溝設計，輝度值可達 2400cd/m2 以上，均齊性 80%以上，超薄得設計可提供顯示器面板所需的足夠光源，並降低背光模組的厚度及重量。目前該研究團隊已開發完成國內學研單位中厚度最薄的 2.5 吋高亮度超薄型導光板(厚度 0.45mm)，且領先目前業界主流的 0.6mm 厚度。研發成果具高實用價值，獲得國碩公司高度興趣，目前已進行產學合作案。同時也獲今年國科會計畫補助，將繼續朝 0.3mm 的厚度發展。



2007 台北國計發明暨技術交易展

超薄型導光板光學設計及精密成形

本校並於 2007 年 9 月 27 日在台北世貿中心與工業技術研究院簽屬「研發服務合作聯盟」，簽約儀式由高應科大研發長黃俊欽教授代表與會。研發服務合作聯盟主要目的是結合學研單位的研發成果，進行加值及整合，以技術整合的概念提高單一技術的價值，更能滿足企業的需求，也更有利於學研單位研發成果的推廣應用。